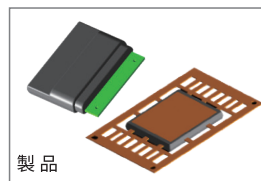


满足量产化需求的服务流程

咨询

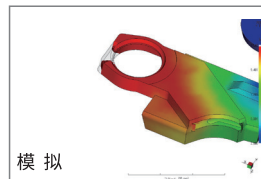
当您有任何想实现的产品、降低成本、开发新产品或改进现有产品的需求时，欢迎通过邮件、电话及公司主页等进行咨询。



製品

提交技术方案与试制

根据客户面临的课题及需求，结合我司多年积累的技术经验，为客户提供最合适的解决方案。并可以通过设置在全球各地的实验基地，为客户提供产品的试制服务。



模拟

打样评估与验证

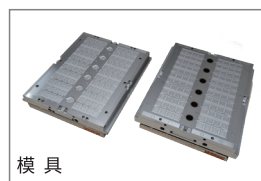
针对试制模成形的样品进行评估和反复改进，并在此基础上最终满足量产要求。



試作

提交模具和设备方案

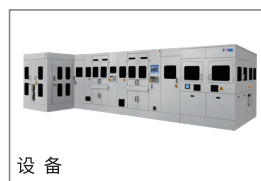
以满足量产要求为目标，为客户提供最合适的模具及设备方案，再经规格确定与议价，获取客户订单并组织模具及设备的制作。



模具

发货与设备安装

邀请客户来访，对模具及设备进行出厂前验收，满足产品要求后发货至客户工厂并进行安装。



设备

产品的市场导入

欢迎咨询半导体以外产品的试制、EMS(代加工) 等业务！

可快速实现试制与评估的全球实验基地网点

本公司在全球设有9处实验室，就近为各半导体制造商的研发团队提供产品的快速试制支持，协同客户反复验证，助推产品早日实现量产，为客户的产品开发尽心尽力。



东和半导体设备（上海）有限公司

地址：中华人民共和国上海市普陀区凯旋北路1188号环球港B座20A

邮编：200063

TEL 021-6888-6860 FAX 021-5835-5305

TOWA（本公司商标），是TOWA株式会社的商标或注册商标。



Website



Contact

20251101-008-HQ

SEMICONDUCTOR EQUIPMENT PRODUCT LINE-UP

半导体制造设备介绍



技术介绍

压缩成形

Comp.
Information ▶



压缩方式

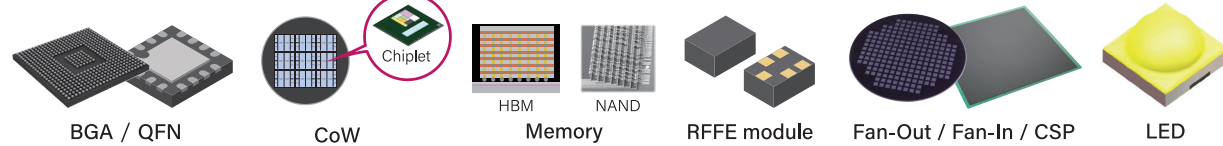
将型腔内的树脂进行压合而不产生树脂流动的塑封方式

*采用Cavity Down构造
树脂均匀地撒在下型腔，
并将设置于上模的基板浸入至熔化的树脂里的成形方法

特点

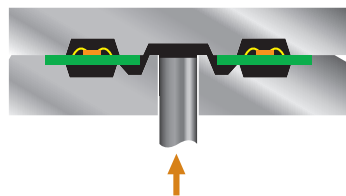
- 几乎无树脂流动
通过将树脂流动控制至最小来防止芯片位移和冲丝不良等的发生
- 最适合晶圆/面板级大尺寸的封装成形
撒料均匀，可实现高品质成形

适用产品



注塑成形

Tr.
Information ▶



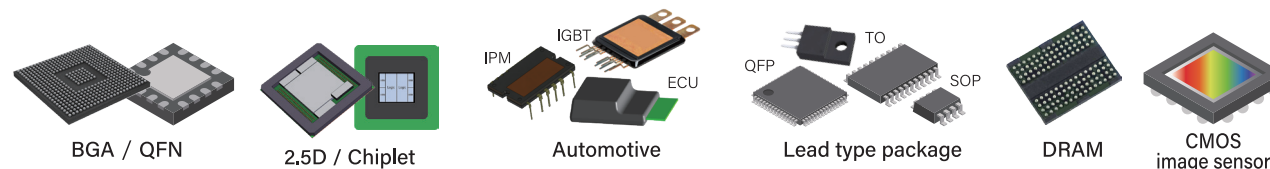
注塑方式

向型腔里注入树脂的成形方式

特点

- 可对应复杂多变形状的Package
通过模具设计可对应单颗、双面等各种Package形状的成形
- 最适合芯片或基板露出产品的封装成形

适用产品



切割

Sing.
Information ▶



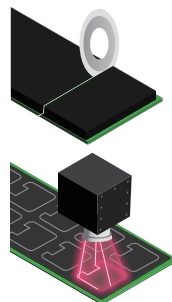
将Molding后的产品切割成单颗产品的工艺

特点

- 提供刀片式和激光式两种类型，以满足客户多样化的需求
- 支持从小型封装到厚封装、基板以及不规则形状切割等各种应用
- 采用自主研发的切割引擎和Handler，实现高精度切割及高速搬送

◆ Blade

◆ Laser



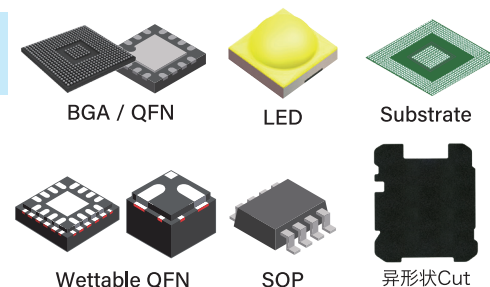
单颗化
收纳

Bulk / Tray / Ring offload



*激光切割设备适用于Bulk类型

适用产品

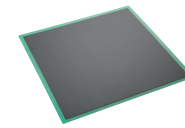


主力机型

CPM1180



用于大尺寸PLP成形的
压缩成形系统，
满足行业需求

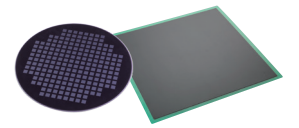


适用产品 Large PLP

CPM1080



用于实现WLP/PLP塑封工艺的
高精度·高生产率的
新型压缩成形设备

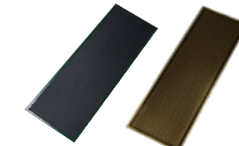


适用产品 WLP / PLP

PMC2030



应对市场需求的
终极压缩成形设备

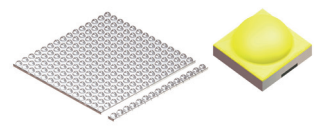


适用产品 MAP BGA / MAP QFN

LCMseries



采用独创成形手法的
专用于LED封装的
压缩成形设备

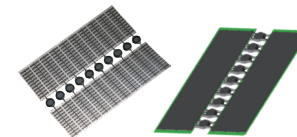


适用产品 LED

YPM1180



用于高质量成形的
多合一注塑成形设备

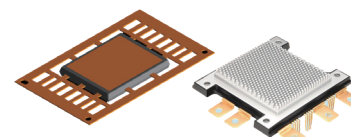


适用产品 SOP / QFP / QFN

YPM1120



车载和功率模块的
专用塑封设备

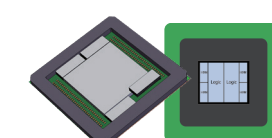


适用产品 IPM / ECU / IGBT

YPM1250-EPQ



2.5D/3DIC/Chiplet产品的
注塑成形设备

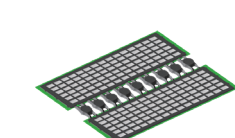


适用产品 CPU / GPU

YPM1080-EP



适用于芯片露出成形和
塑封厚度可变的注塑成形设备

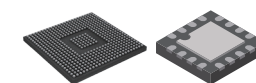


适用产品 e-MUF / BGA / DRAM

PSS2040



适用于□330mm的切割设备

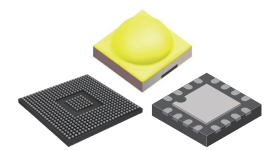


适用产品 BGA / QFN / Substrate

FMS4040



可实现省劳动力化生产的
切割设备

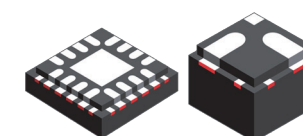


适用产品 BGA / QFN / LED

LGR1040



适用于Wettable QFN封装的
Half Cut设备

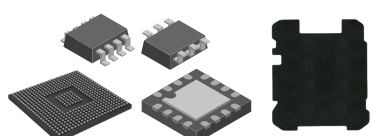


适用产品 Wettable QFN

LSG1040



融合异形形状与直线激光切割，
实现高产能的激光



适用产品 BGA / QFN / SOP